

2022年度 第4四半期 決算説明資料

2023.4.20

将来の見通しに関する注意事項

このプレゼンテーションに掲載されている当社の現在の計画、見通し、戦略、その他の歴史的事実でないものは、将来の業績に関する見通しであり、これらは現在入手可能な情報から得られた当社の経営者の判断に基づいております。

実際の業績は、さまざまな重要な要素により、これらの業績見通しとは大きく異なる結果となりうることをご承知おきください。

実際の業績に影響を与える重要な要素には、世界・日本経済の動向、急激な為替相場の変動ならびに戦争・テロ活動、災害や伝染病の蔓延等があります。

売上高

2,841 億円

前年 2,537 億円

過去最高

GP率

64.9 %

前年 60.7 %

過去最高

営業利益

1,104 億円

前年 915 億円

過去最高

利益率

38.9 %

前年 36.1 %

過去最高

CAPEX

149 億円

前年 456億円

R&D

224 億円

前年 198億円

総資産

4,687 億円

前年 4,045億円

4年累計経常利益率

34.4 %

前年 30.8 %

FCF

687 億円

前年 400 億円

ROE

25.9 %

前年 24.3 %

過去最高

EPS ※

765.47 円

前年 611.67 円

年間配当

1株あたり

916 円

前年 808円

過去最高

※2023年4月1日付の株式分割を踏まえ算定

(単位：百万円)	FY2022	FY2022	QoQ		FY2021	YoY	
	4Q	3Q	差額	(%)	4Q	差額	(%)
売上高	79,015	65,838	13,177	20.0%	73,512	5,503	7.5%
売上総利益	51,224	43,092	8,132	18.9%	45,010	6,213	13.8%
GP率	64.8%	65.5%	-0.7p	-	61.2%	3.6p	-
販売管理費	19,939	18,835	1,104	5.9%	16,747	3,192	19.1%
営業利益	31,284	24,257	7,028	29.0%	28,263	3,021	10.7%
経常利益	32,150	22,605	9,544	42.2%	28,552	3,598	12.6%
経常利益率	40.7%	34.3%	6.4p	-	38.8%	1.9p	-
税前利益	32,726	22,522	10,204	45.3%	28,514	4,213	14.8%
純利益	25,671	16,546	9,126	55.2%	20,697	4,975	24.0%

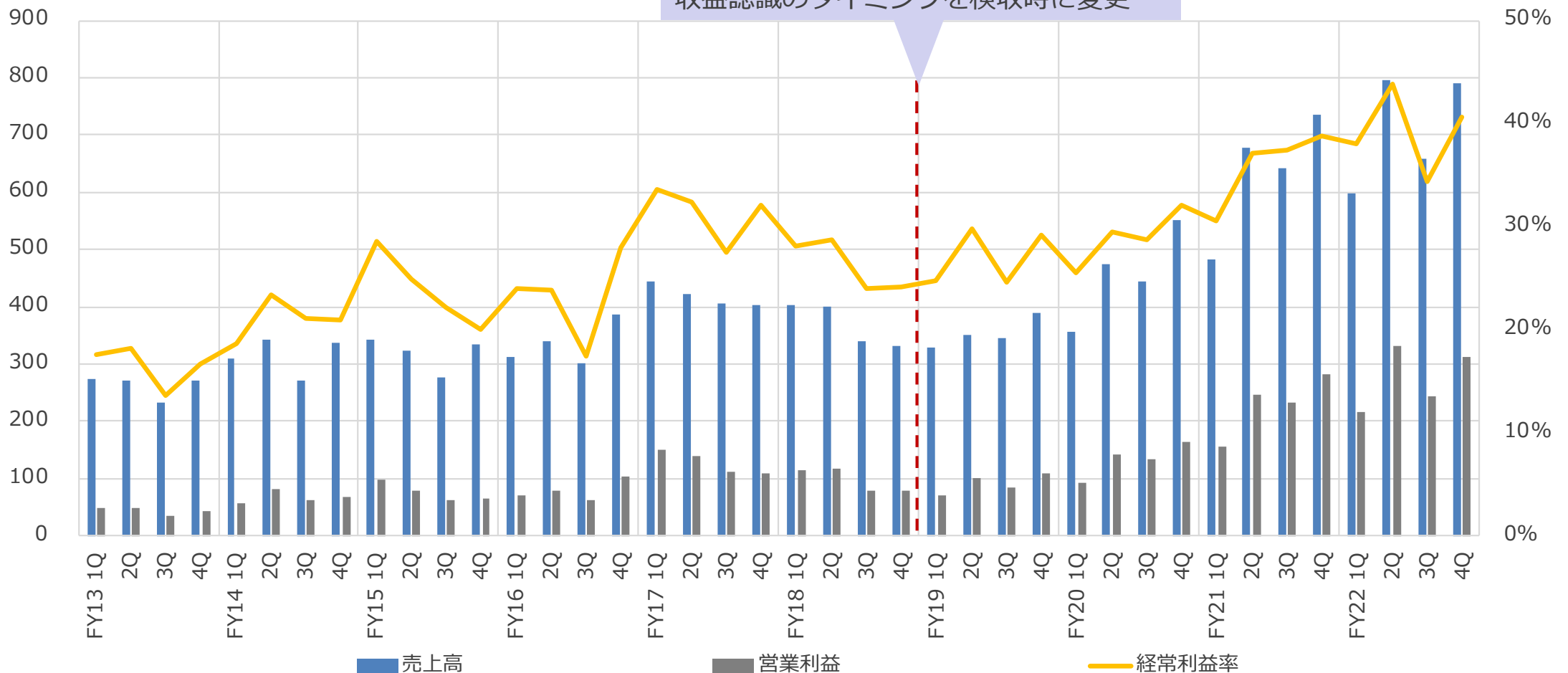
売上高： QoQ 検収の進捗により大幅増加
 GP率： QoQ 製品構成の変化及び業績連動費用増により低下
 販売管理費： QoQ 業績連動により人件費等が増加

(単位：百万円)	FY2022 Full Year	FY2021 Full Year	YoY	
			差額	(%)
売上高	284,135	253,781	30,354	12.0%
売上総利益	184,506	154,011	30,495	19.8%
GP率	64.9%	60.7%	4.2p	-
販売管理費	74,093	62,498	11,596	18.6%
営業利益	110,413	91,513	18,900	20.7%
経常利益	112,338	92,449	19,890	21.5%
経常利益率	39.5%	36.4%	3.1p	-
税前利益	112,785	92,251	20,534	22.3%
純利益	82,891	66,206	16,685	25.2%

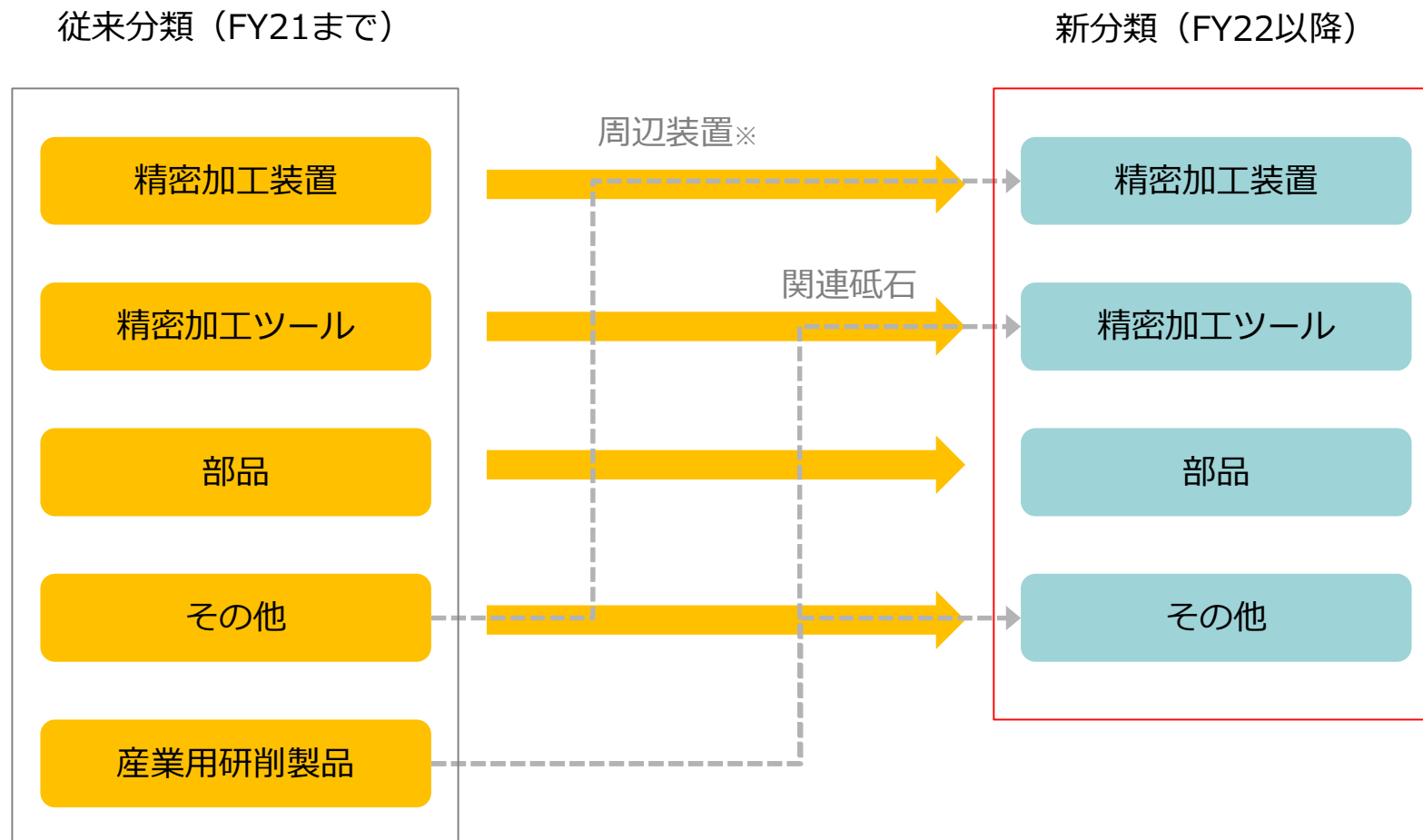
売上高： 高水準の製品出荷を背景に検収売上が伸長（過去最高更新）
 GP率： 主に為替影響により大幅上昇
 販売管理費： 主に業績連動費用が増加

(単位：億円)

会計方針変更により
収益認識のタイミングを検収時に変更



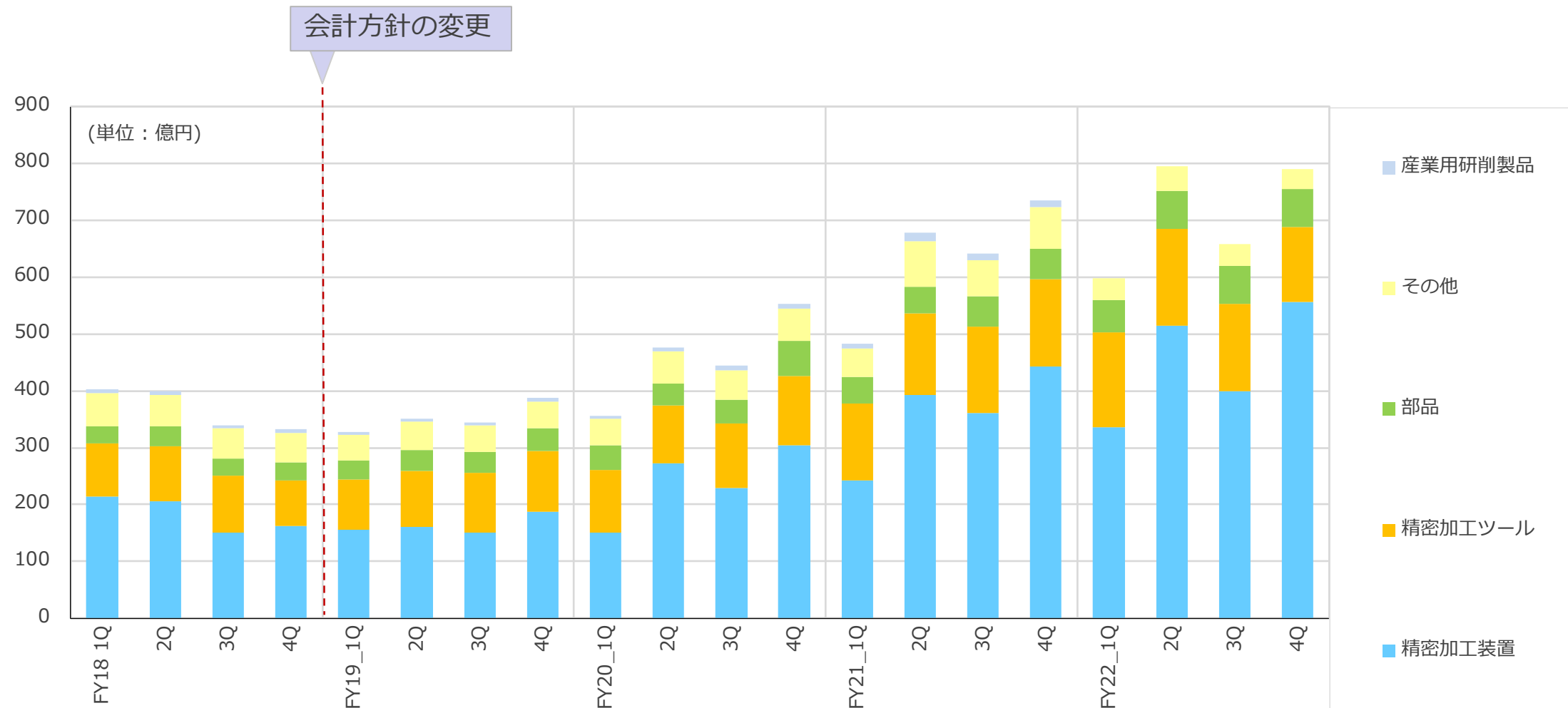
検収が進捗し売上高が増加、各利益率は高水準で推移
(FY22_4Q 営業利益率39.6% 経常利益率40.7% 純利益率32.5%)



※ウェーハマウンタ、純水リサイクル装置など

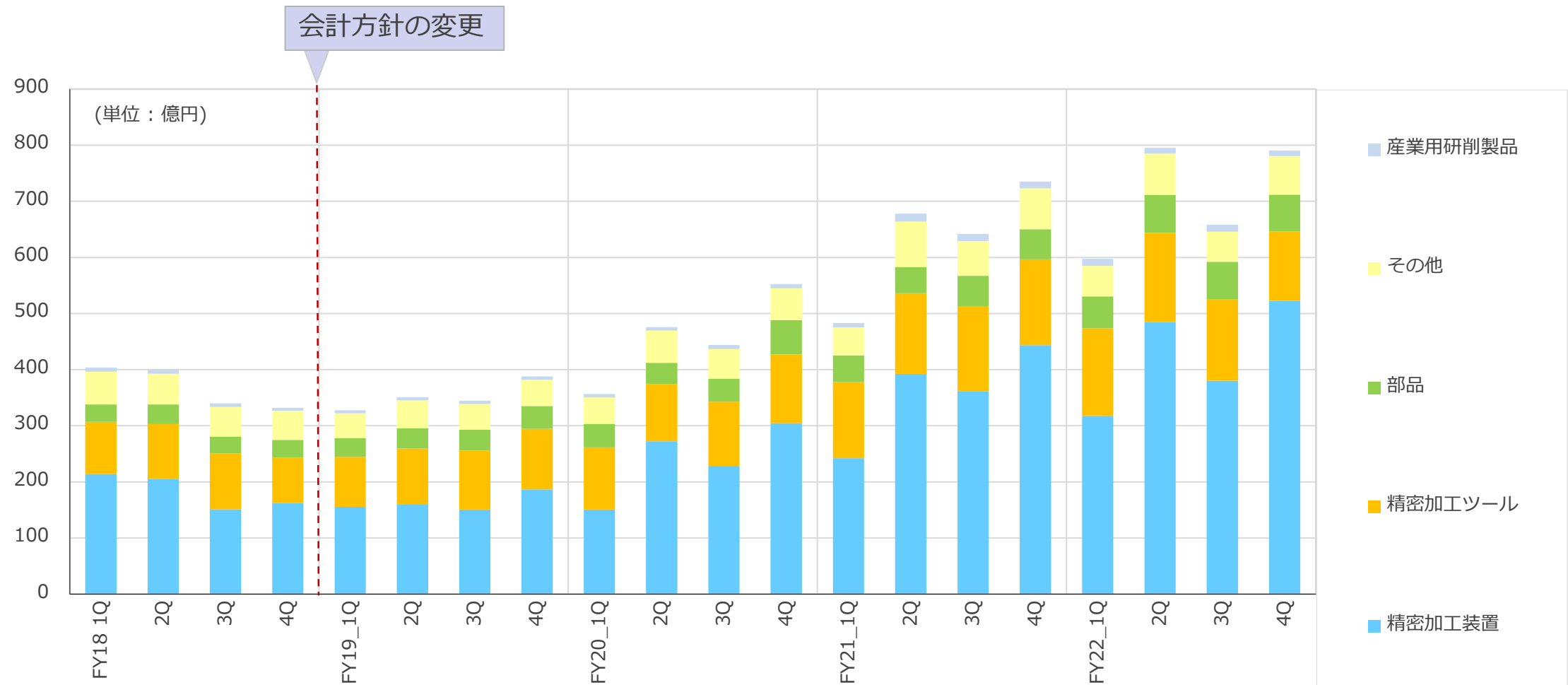
「その他」および「産業用研削製品」について分類を変更

製品群別売上高 四半期推移



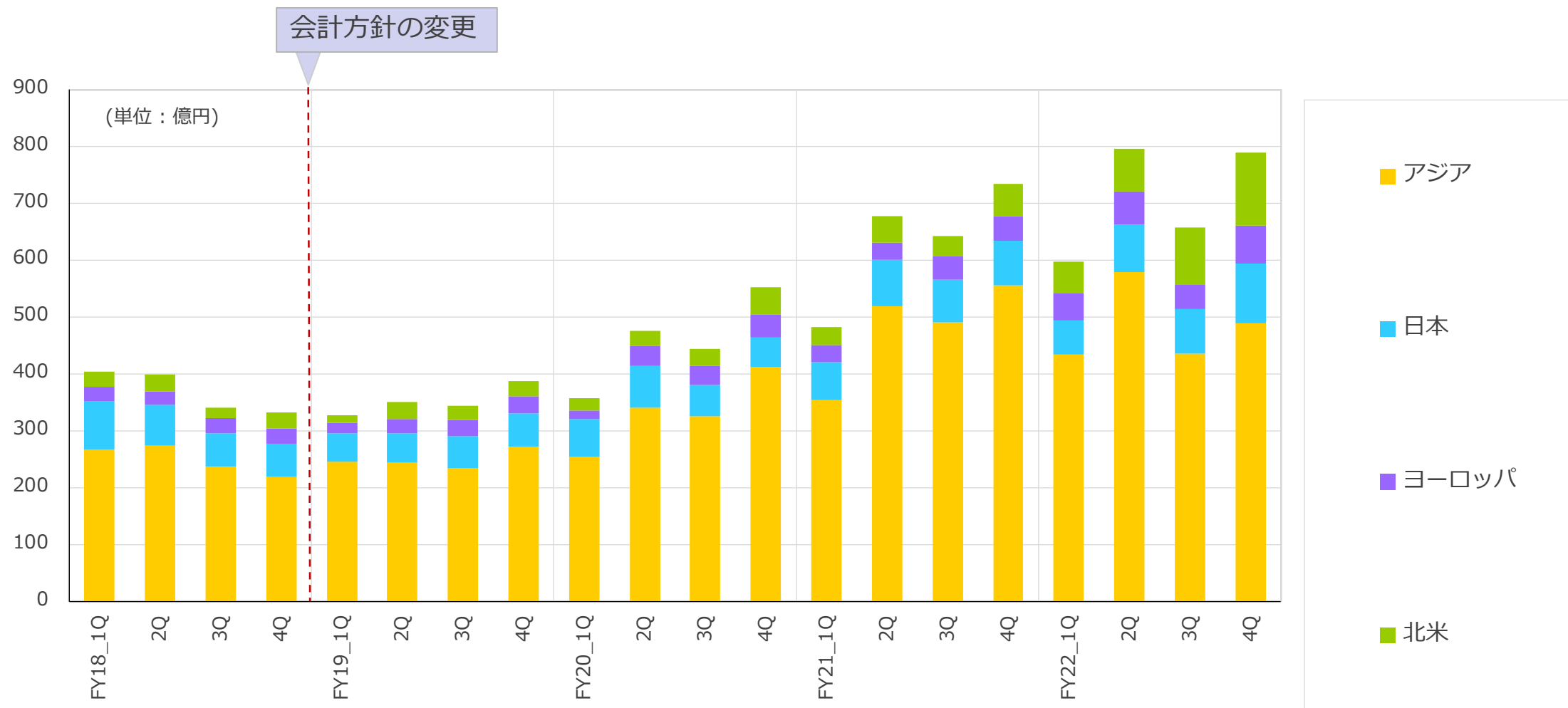
※構成比数値は、Webサイト「補足情報」に記載

【参考】製品群別売上高 四半期推移

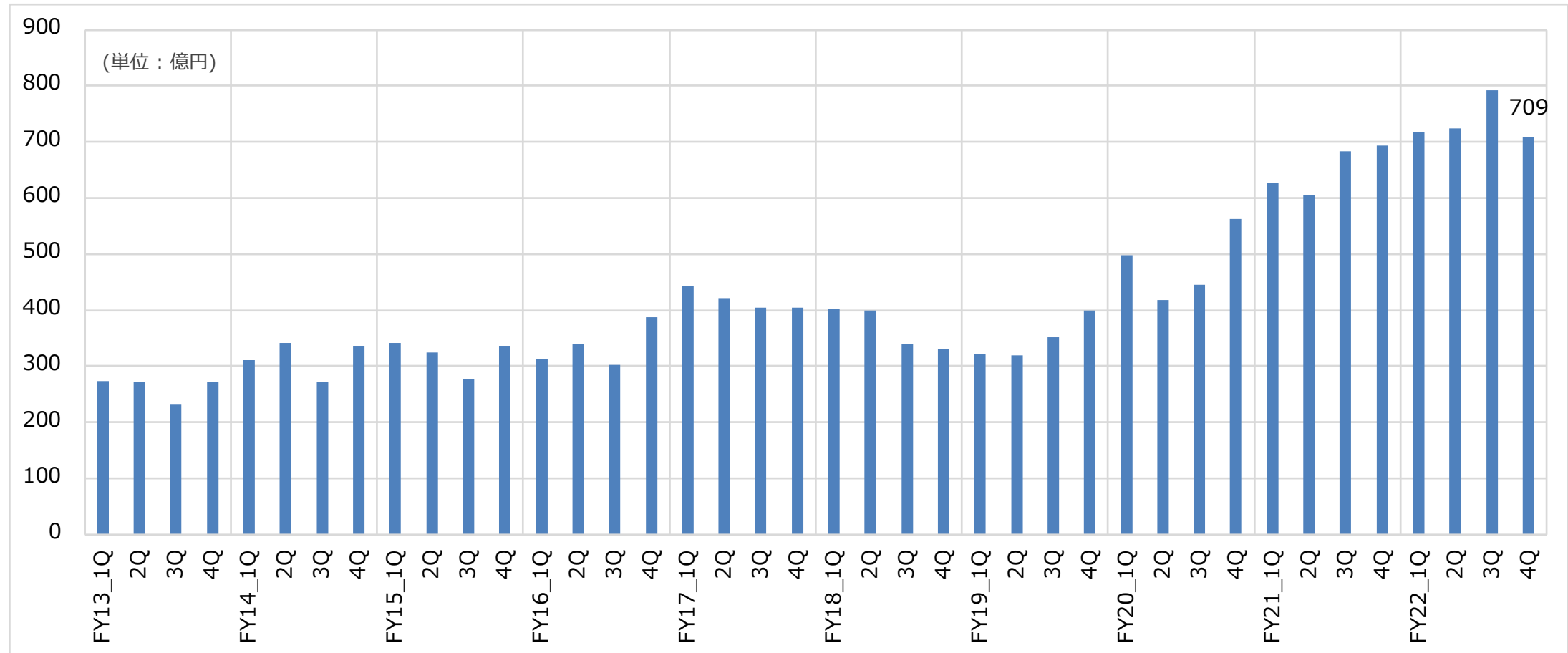


従来分類による推移

地域別売上高 四半期推移

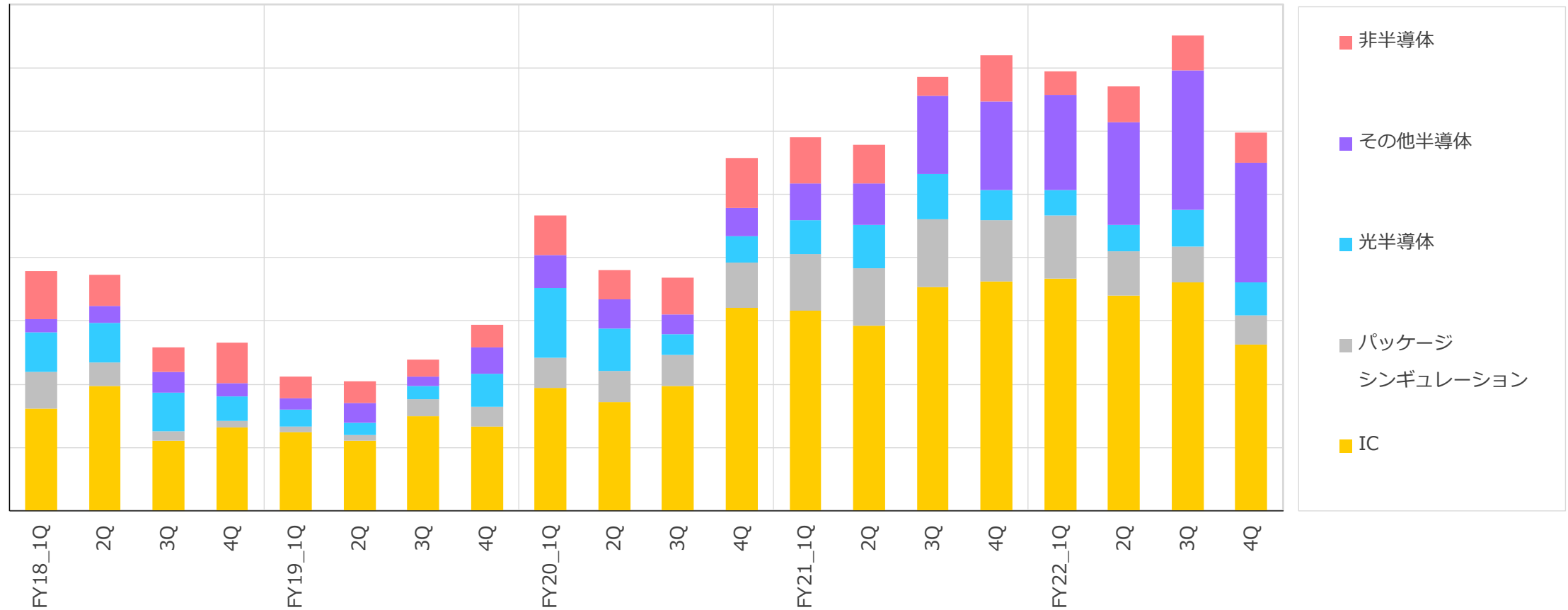


FY22_4Q 海外売上高比率 86.7%



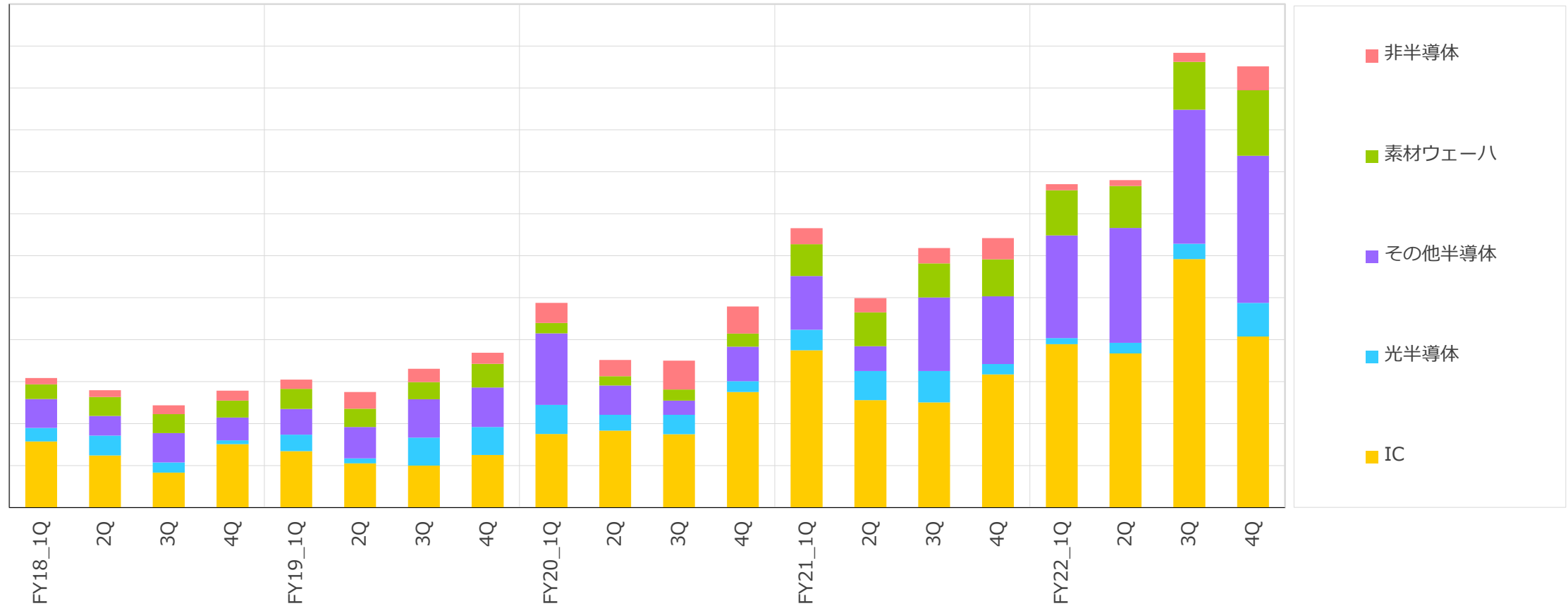
FY22_4Q 出荷額 約709億円

出荷額ベース

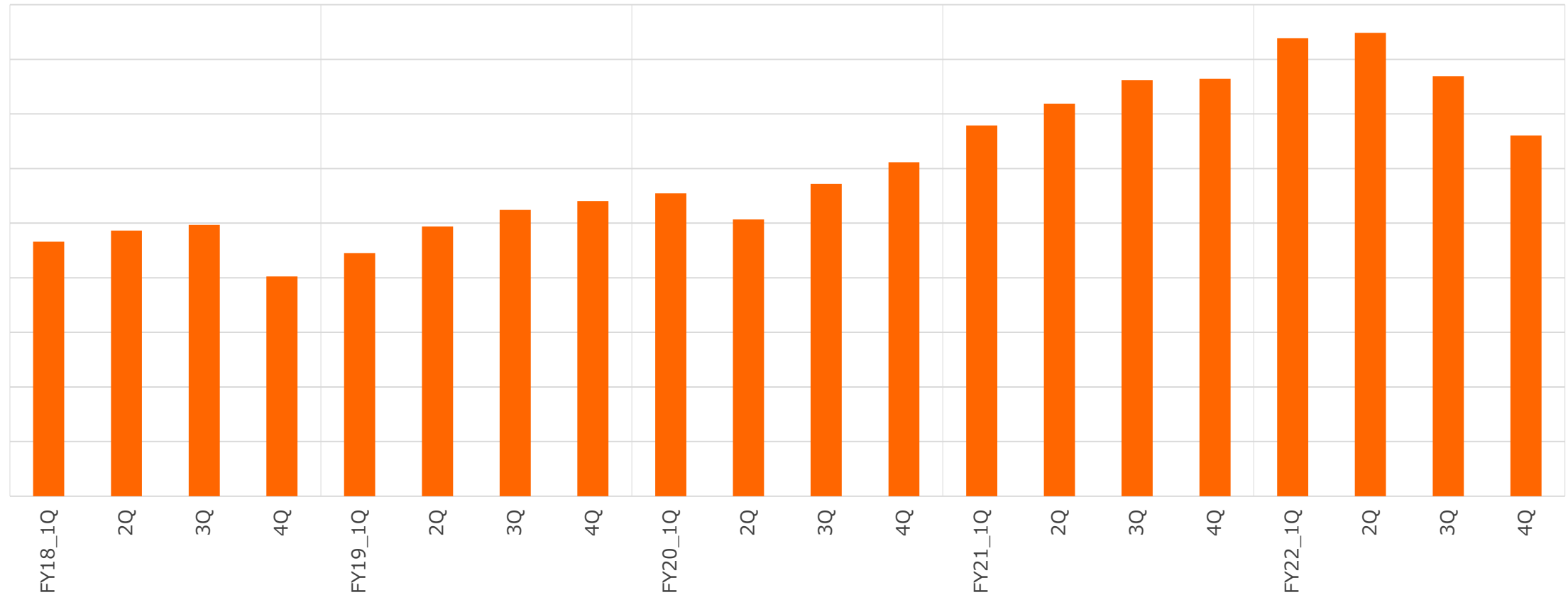


QoQ パワー半導体（その他半導体）は高水準を維持したが、ICが減少
 YoY パワー半導体（その他半導体）は増加したが、 ICの減少が全体を押し下げた

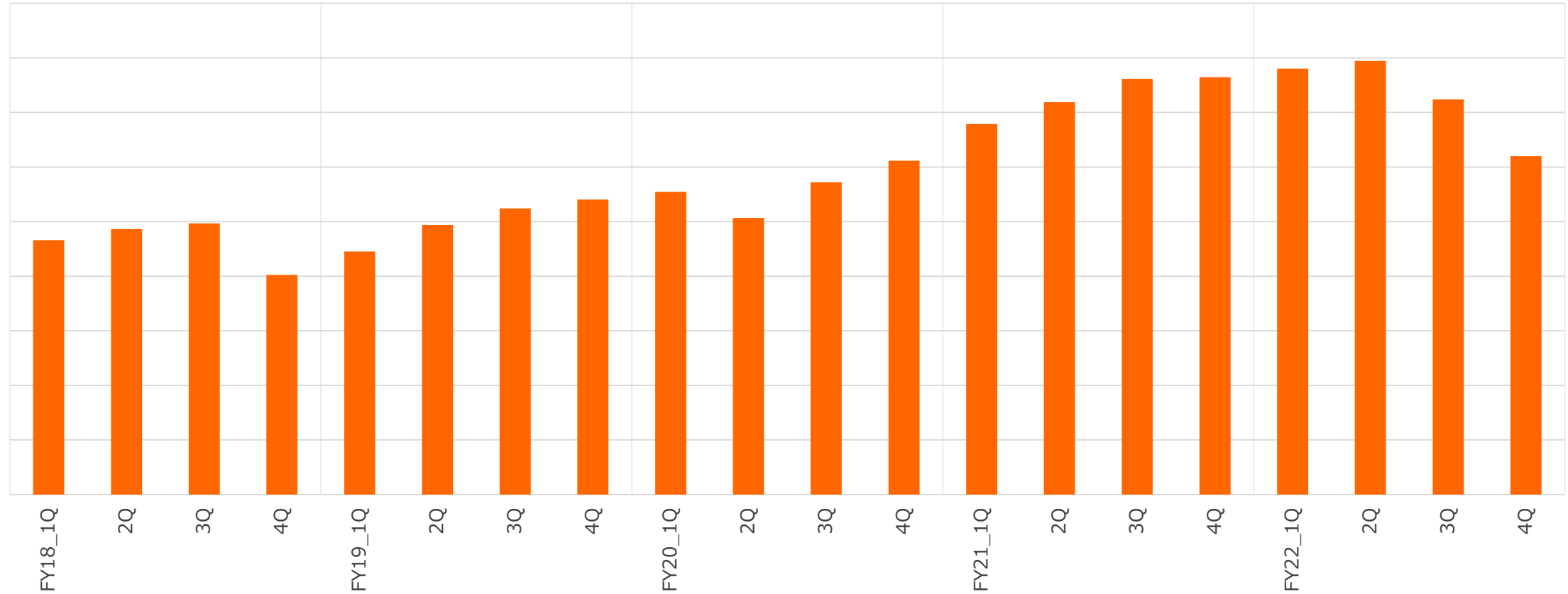
出荷額ベース



QoQ パワー半導体（その他半導体）、素材ウェーハが好調維持
 YoY パワー半導体（その他半導体）の増加が全体を押し上げた



精密加工ツール（消耗品）の出荷は季節性および顧客の設備稼働率低下などにより減少
 ※FY22_1Qより、従来他区分だった「関連砥石」を含む



従来分類による推移

(単位：百万円)	FY2022 4Q	FY2022 3Q	差額
現金及び預金	163,053	139,576	23,477
受取手形・売掛金	41,356	36,343	5,013
棚卸資産	91,384	91,013	370
流動資産	305,118	274,718	30,400
有形固定資産	147,541	146,332	1,209
固定資産	163,678	159,894	3,784
総資産	468,797	434,613	34,184
流動負債	119,974	110,743	9,231
固定負債	781	894	-114
負債合計	120,755	111,638	9,117
純資産	348,041	322,974	25,067
負債純資産合計	468,797	434,613	34,184
自己資本比率	74.0%	74.0%	0.0p

総資産：検収が進捗したことにより現預金や売掛金が増加

負債：電子記録債務が減少した一方で、賞与引当や未払法人税等が増加

純資産：主に利益剰余金が増加

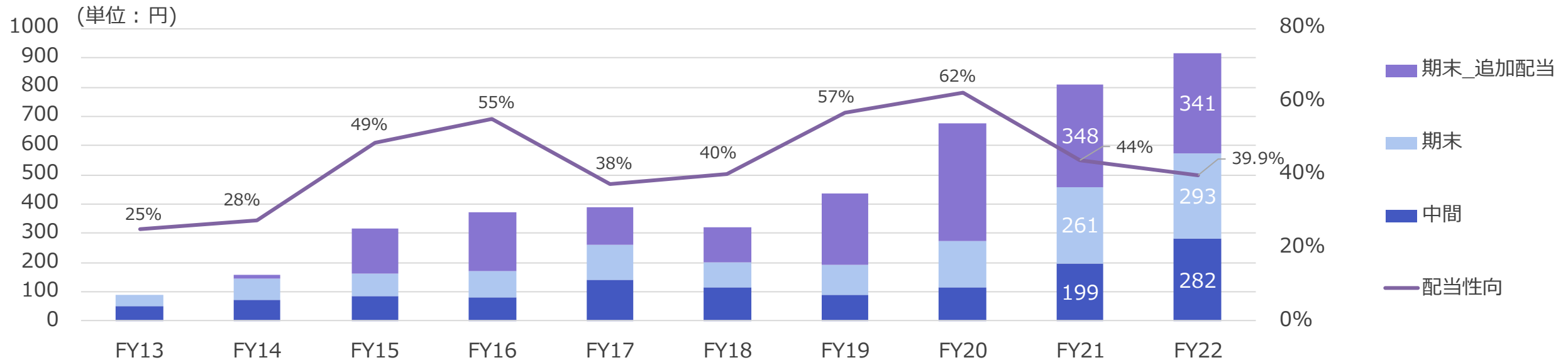
(単位：百万円)	FY2022 Full Year	FY2021 Full Year	差額
営業キャッシュ・フロー	81,783	83,654	-1,872
税前当期利益	112,785	92,251	20,534
減価償却	10,371	8,551	1,820
売上債権の増減	-1,398	-2,923	1,525
棚卸資産の増減	-21,682	-9,594	-12,088
仕入債務の増減	-2,364	6,476	-8,841
法人税支払い	-33,463	-21,182	-12,281
その他営業CF	17,535	10,075	7,460
投資キャッシュ・フロー	-13,077	-43,591	30,515
有形固定資産の取得	-14,208	-43,576	29,367
フリー・キャッシュ・フロー	68,706	40,062	28,643
財務キャッシュ・フロー	-32,090	-27,193	-4,897
配当金支払い	-32,154	-27,401	-4,753
現金同等物増減	37,281	15,961	21,320
期首残高	125,771	109,809	15,962
期末残高	163,053	125,771	37,282

- 営業C F・・・約817億円 資金増加
主に税前利益による資金増加
 - 投資C F・・・約130億円 資金減少
主に有形固定資産の取得によるもの
 - フリー・キャッシュ・フロー
約687億円の資金増加
 - 財務C F・・・約321億円 資金減少
主に配当金の支払い
- 3月末の現金残高 約1,630億円

【配当方針】

1. 期末、中間の年2回、連結半期純利益の25%を配当する
2. 安定配当として半期10円（年間20円）を維持。ただし3期連続で連結純損失の場合を除く
3. 期末時点で赤字の場合を除き、配当及び法人税支払い後の現預金残高が予定必要資金額(*)を超過した場合は、上記1.に加え、超過金額の3分の1を目処に配当に上乗せする（追加配当）

*技術購入予備費（技術特許購入、ベンチャーへの出資等）および設備拡張資金、有利子負債返済資金など



FY22（実績）

中間	282円
期末	634円
年間	916円

①	運転資金 $\left[\begin{array}{c} \text{前期} \\ \text{連結売上高} \end{array} \div 12\text{ヶ月} \times 2\text{ヶ月} \right]$	473 億円
	技術購入予備費(M&A含む) $\left[\begin{array}{c} \text{連結売上高} \\ \text{過去3年平均} \end{array} \times 10\% \right]$	190 億円
	長期有利子負債 返済資金	-
	税金・配当 等	172 億円
②	設備拡張資金 $\left[\begin{array}{c} \text{オフィス拡張 等} \end{array} \right]$	82 億円
③	技術購入予備費の取り崩し ※ 2	▲ 144 億円

- ※1 契約負債（前受金）金額などを考慮
- ※2 羽田R&Dセンター取得費用の半額を考慮

(単位：億円)

今回予想

	FY22 1Q	2Q	3Q	4Q	FY23 1Q
売上高	597	795	658	790	533
営業利益	216	333	243	313	165
経常利益	228	348	226	322	166
純利益	160	246	165	257	116
営業利益率	36.1%	41.8%	36.8%	39.6%	31.0%
経常利益率	38.1%	43.8%	34.3%	40.7%	31.1%
純利益率	26.8%	31.0%	25.1%	32.5%	21.8%
出荷額	717	725	792	709	622

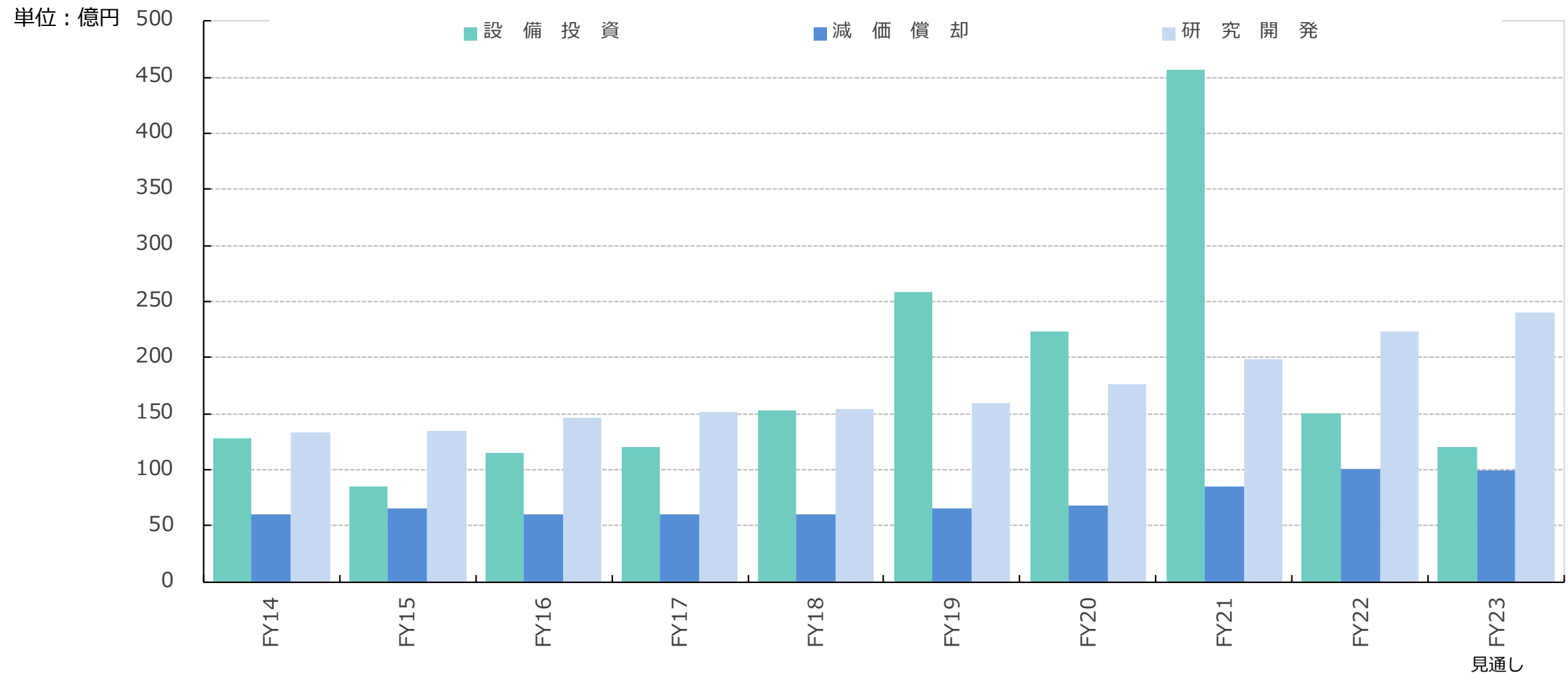
※億円未満 四捨五入

想定為替レート 1Q (4-6月期)
為替感応度 (年換算)

US\$: 120円 Euro : 135円
US\$: 約12億円 Euro : 約3千万円

出荷額ベース

製品群		見通し FY23_1Q 増減率 (QoQ)
	ブレードダイサ	-20%
	レーザソー	-25%
	ダイサ	-20%
	薄化DGP	-10%
	薄化以外	-5%
	グラインダ	-10%
	周辺装置	微増
	精密加工装置	-15%
	精密加工ツール	微増
	その他	-20%

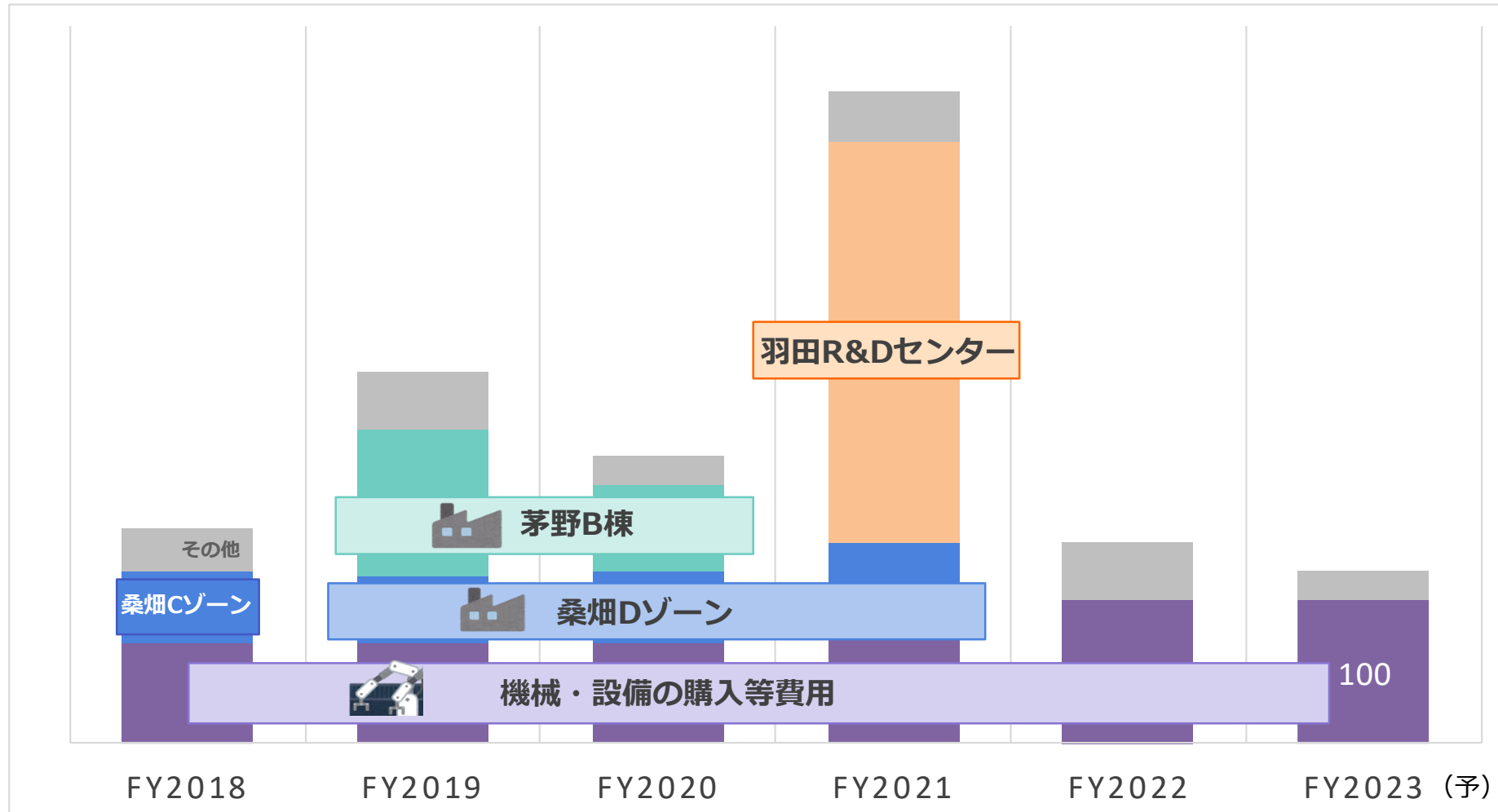


FY23見通し

設備投資：合理化投資を中心に実施
 減価償却：前年度と同等を見込む
 研究開発：積極的な研究開発を予定

120億円程度 (FY22実績 149億円)
 100億円程度 (FY22実績 100億円)
 240億円前後 (FY22実績 224億円)

単位：億円



FY23見通し

機械・設備の購入等費用
他 オフィス拡張など

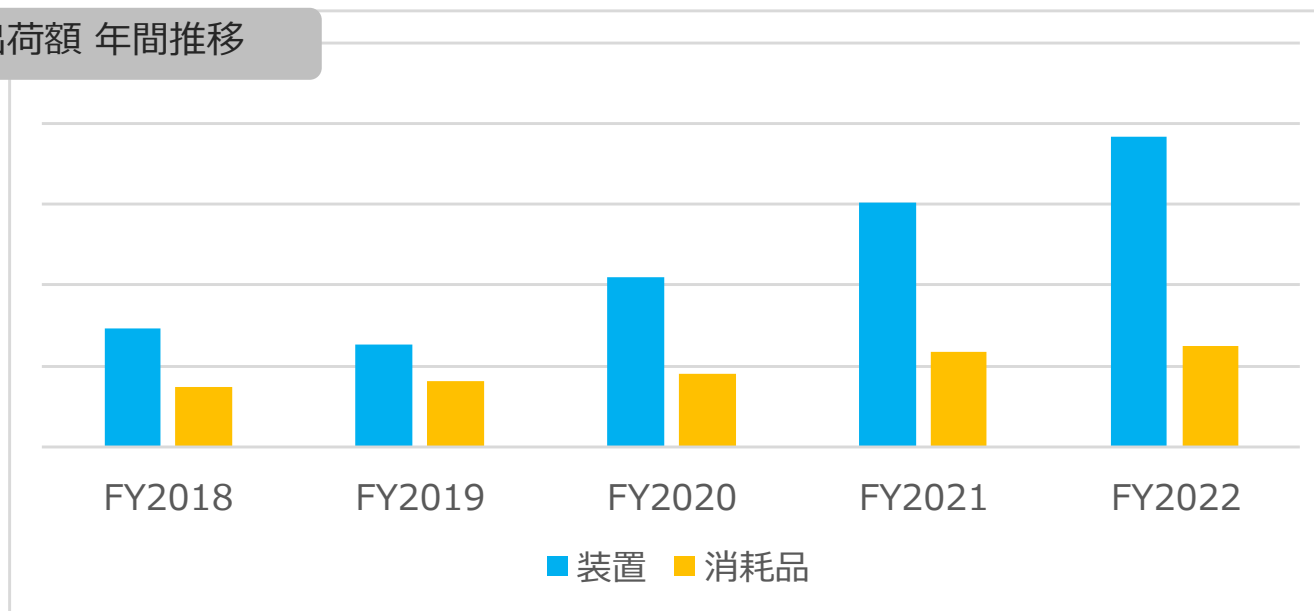
約100億円
約20億円

■ 出荷動向

PC・スマホ向けの需要は減退

一方でパワー半導体向けなどを他用途で出荷は堅調に推移
装置、消耗品、共に過去最高を更新

出荷額 年間推移

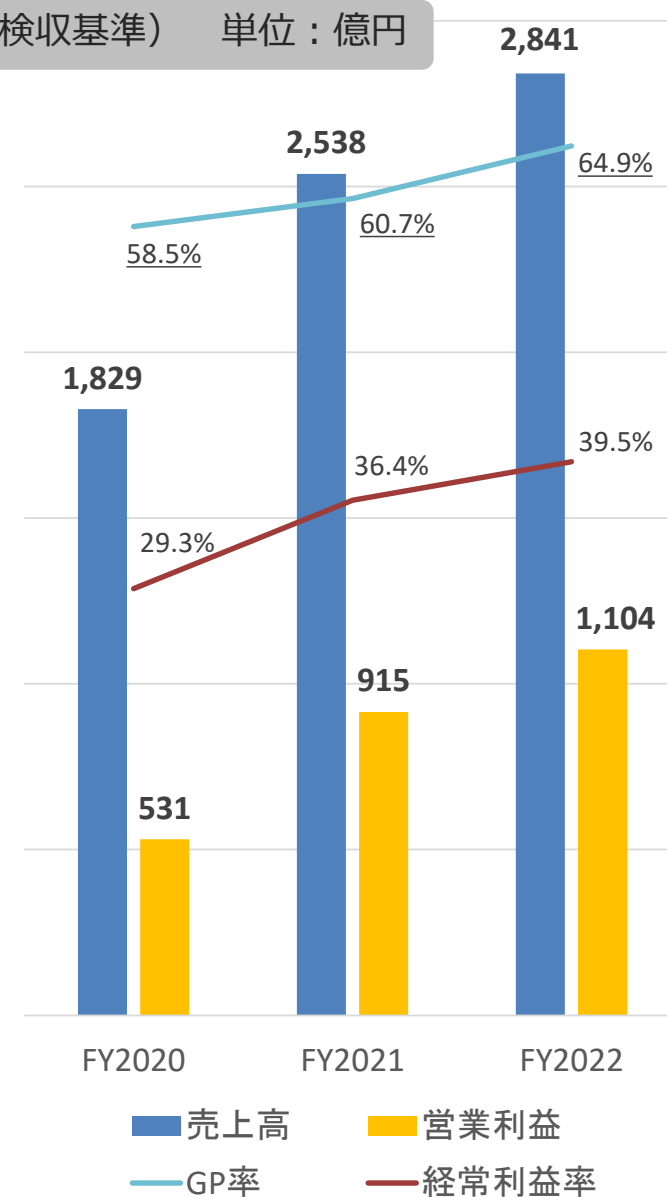


■ 3期連続最高益 収益性も上昇

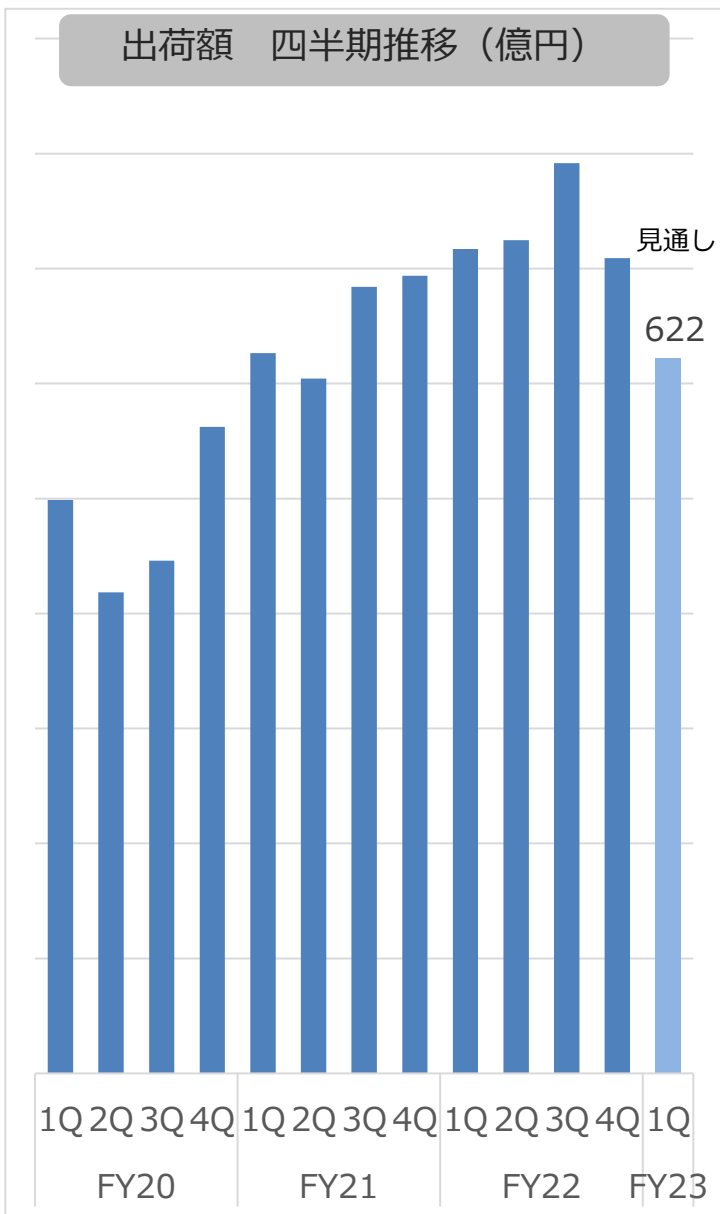
為替など外部環境も追い風となりGP率・利益率は過去最高

■ 業績連動と余剰資金からの配当により増配 (年間916円 ※前年808円)

年間推移 (検収基準) 単位: 億円



出荷額 四半期推移（億円）

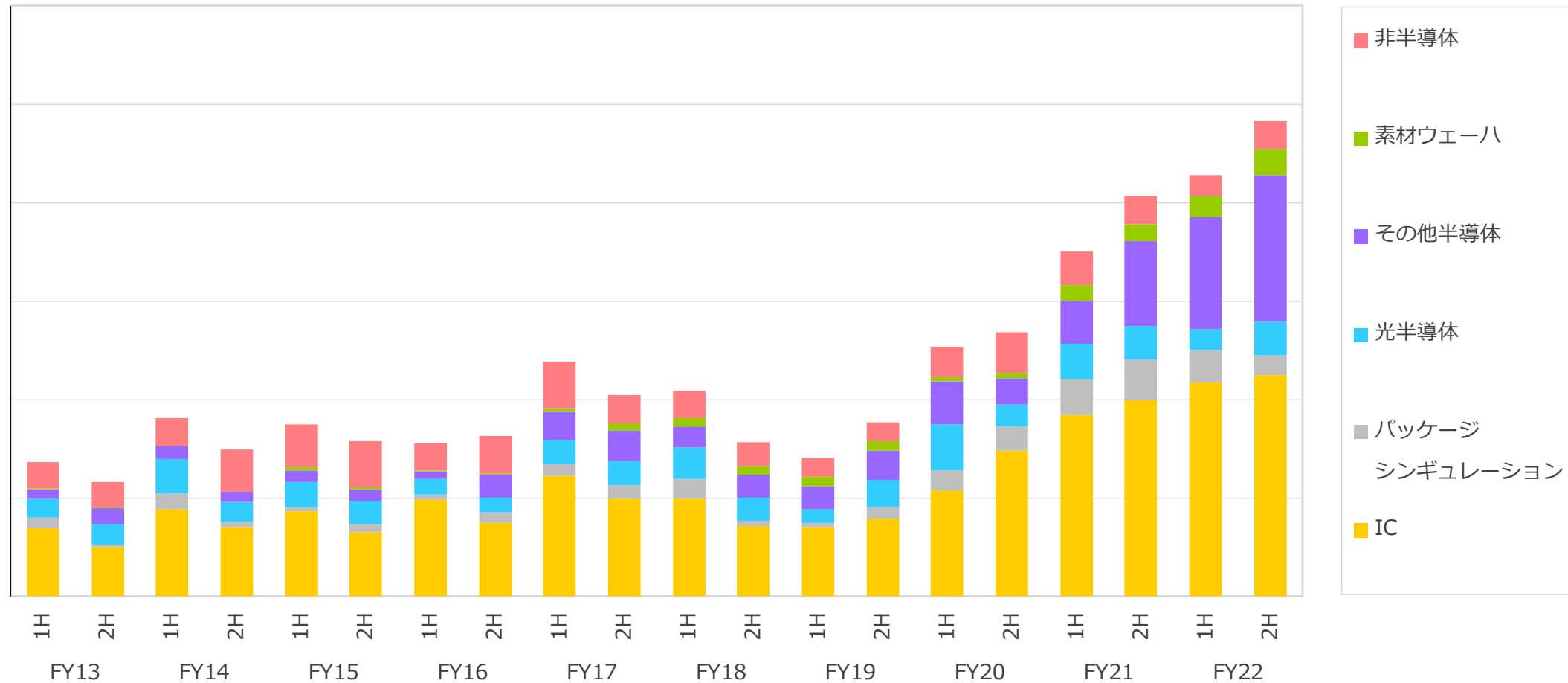


- 引き続きパワー半導体は高水準の出荷を見込むが、量産用途（OSAT、メモリなど）の需要低迷により出荷額は低調
- 精密加工ツール（消耗品）は顧客の設備稼働率などを注視
- 引き続き「会社を強くする」ことに注力
 - 価値創出・信頼関係などを自己評価し必要な修正を行える人財を育成することを目的として「コミット手当」を新設
 - DISCO VALUES、Will会計、PIM活動も引き続き注力
- 「高度なKKM技術」の開発テーマは増加、全力で対応中

- 【ご参考】 半期・通期推移 グラフ集

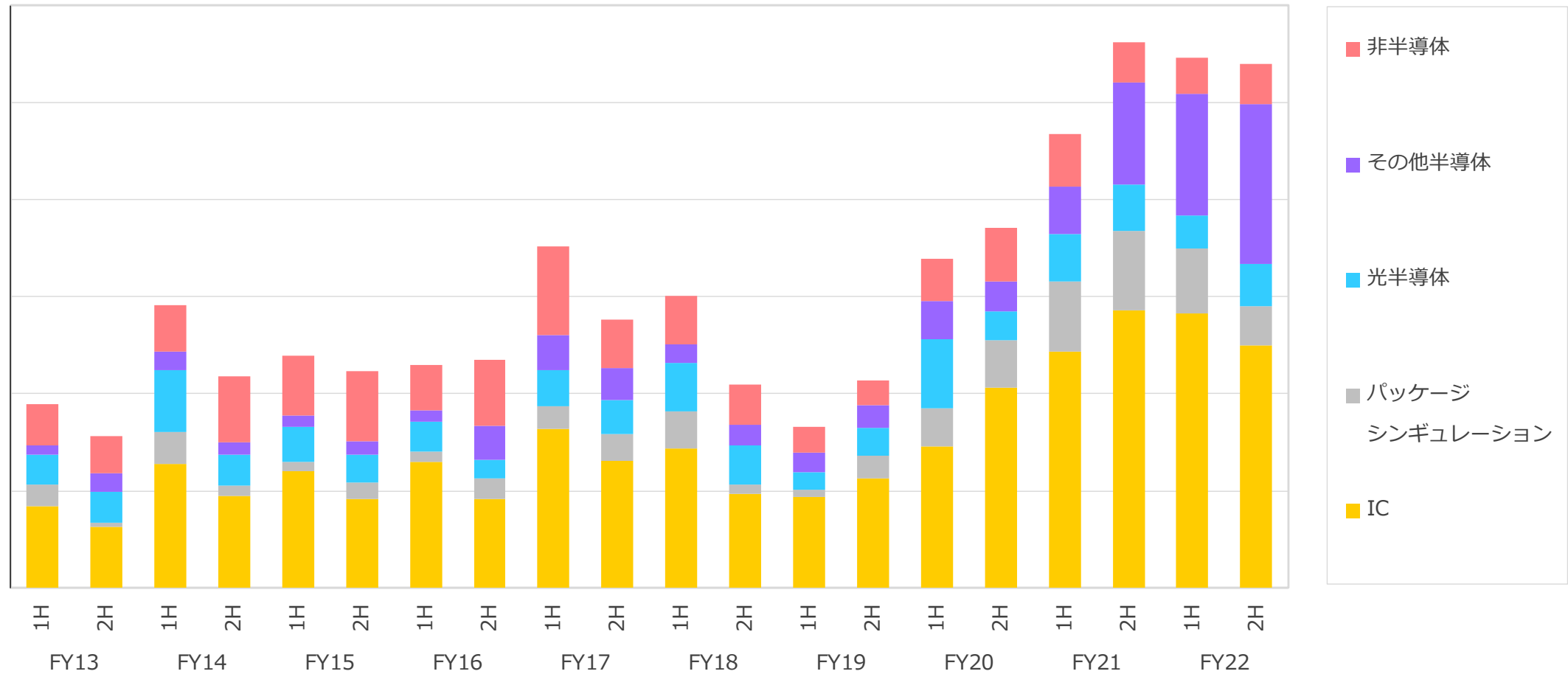
出荷額ベース

半期



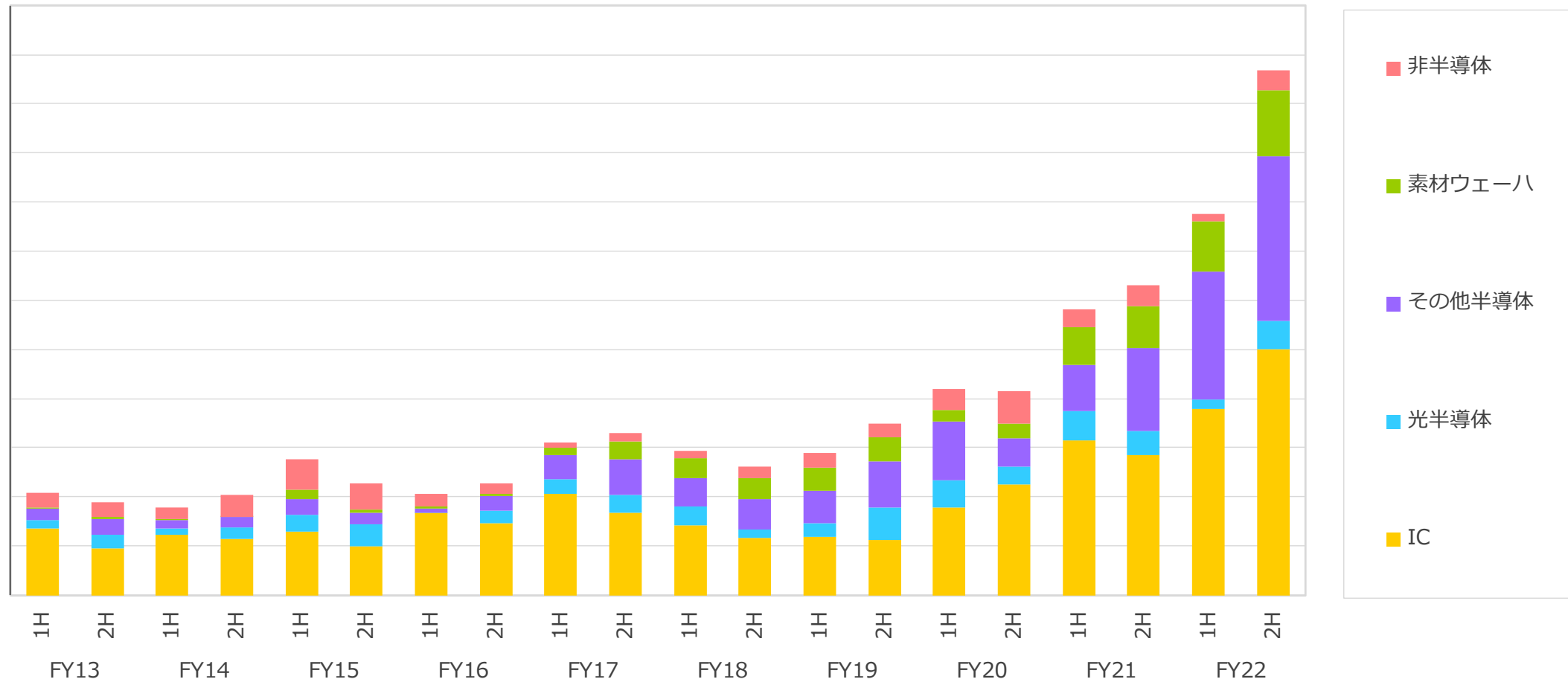
出荷額ベース

半期



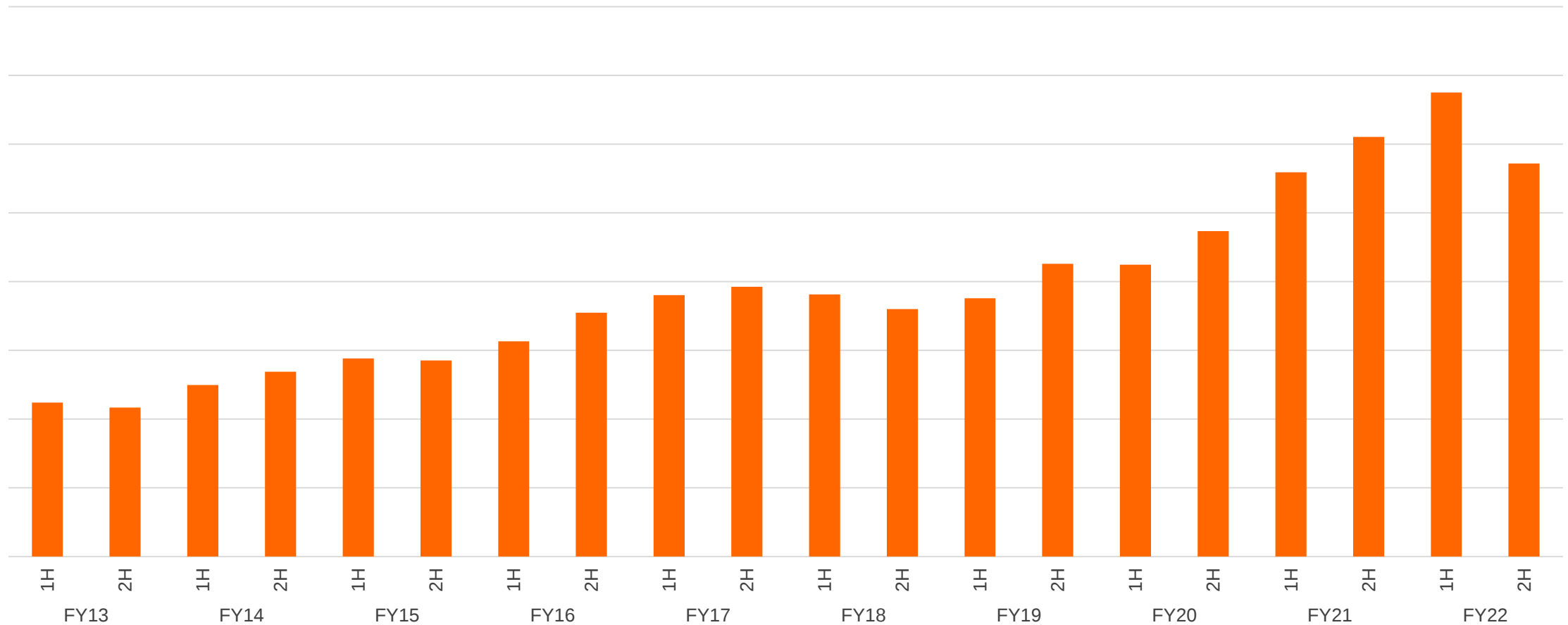
出荷額ベース

半期



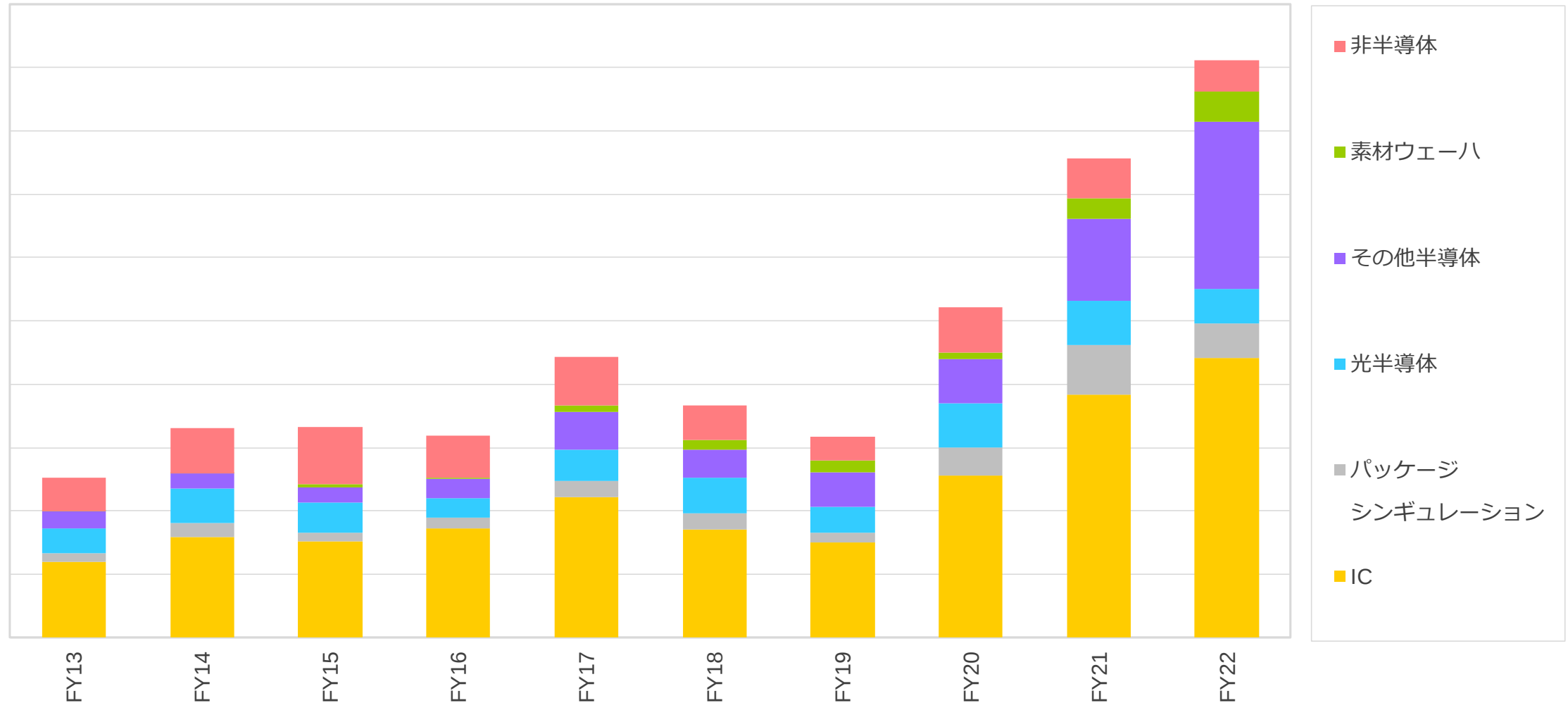
出荷額ベース

半期



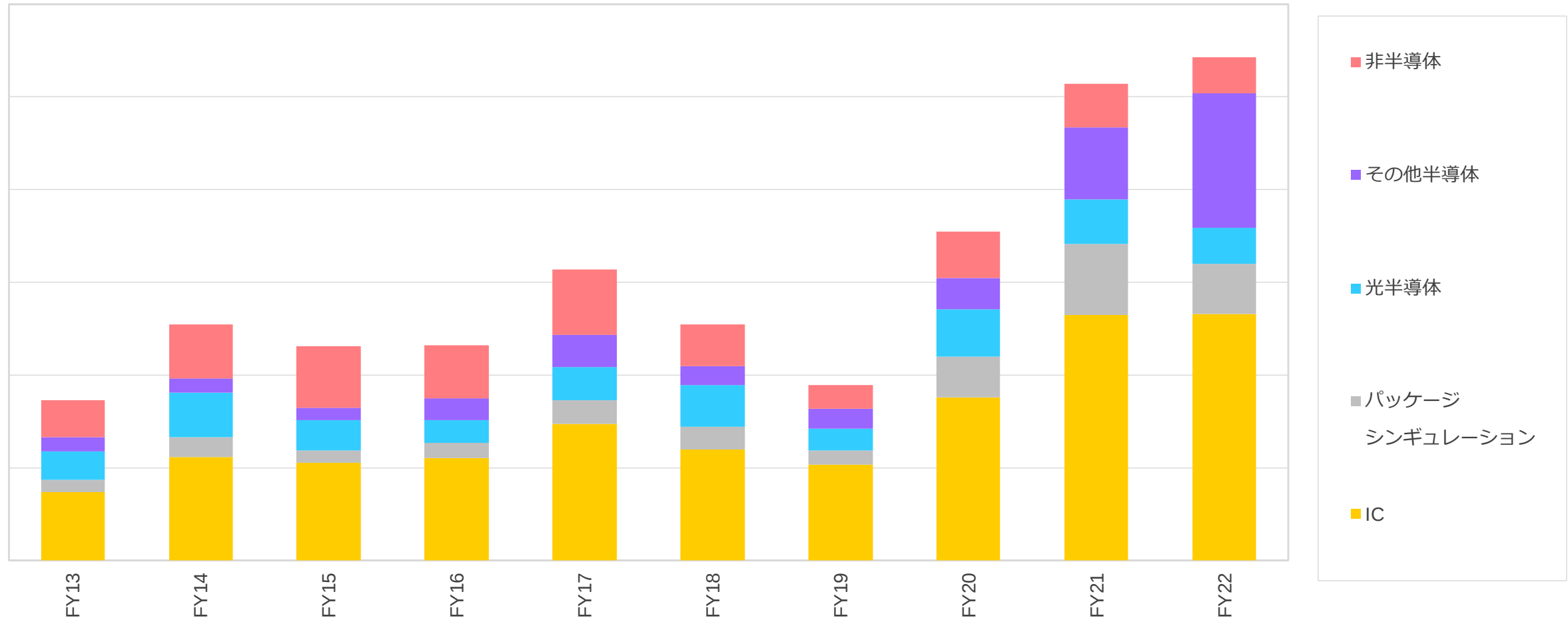
出荷額ベース

通期



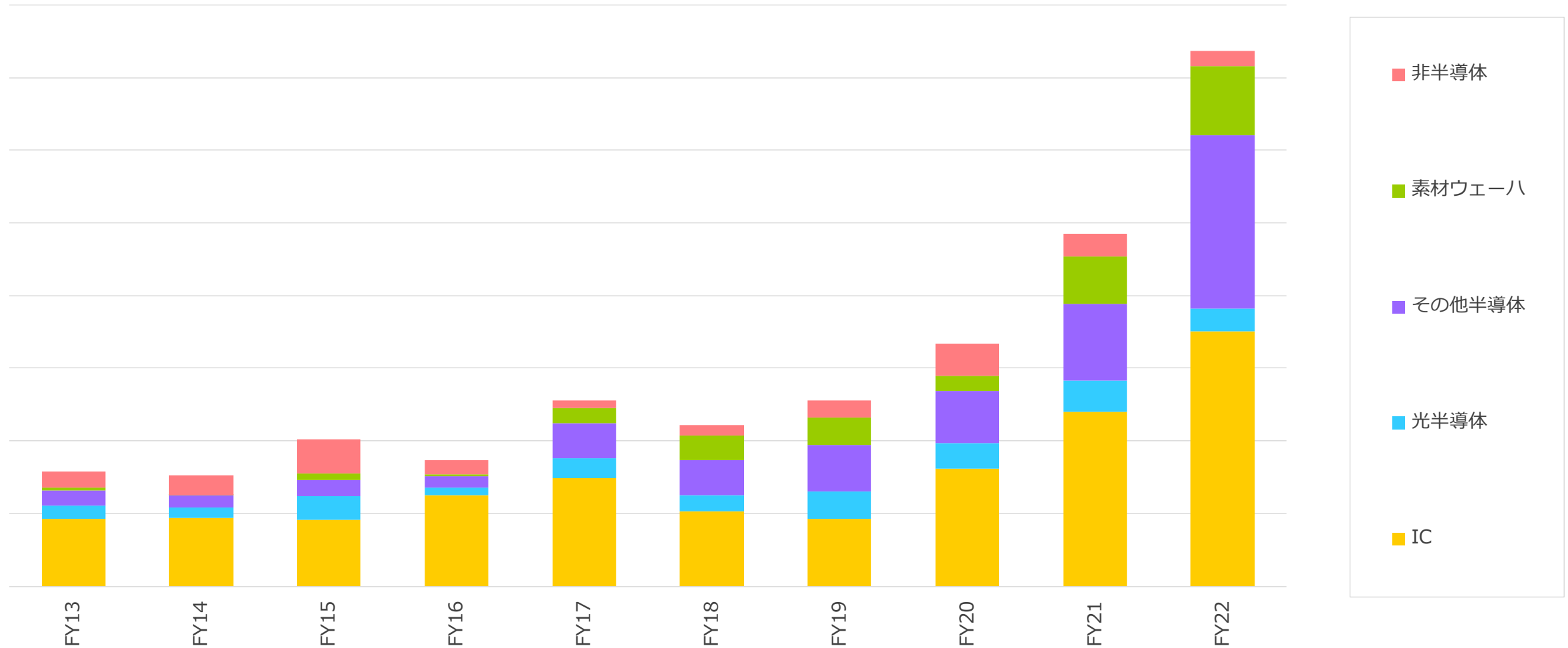
出荷額ベース

通期



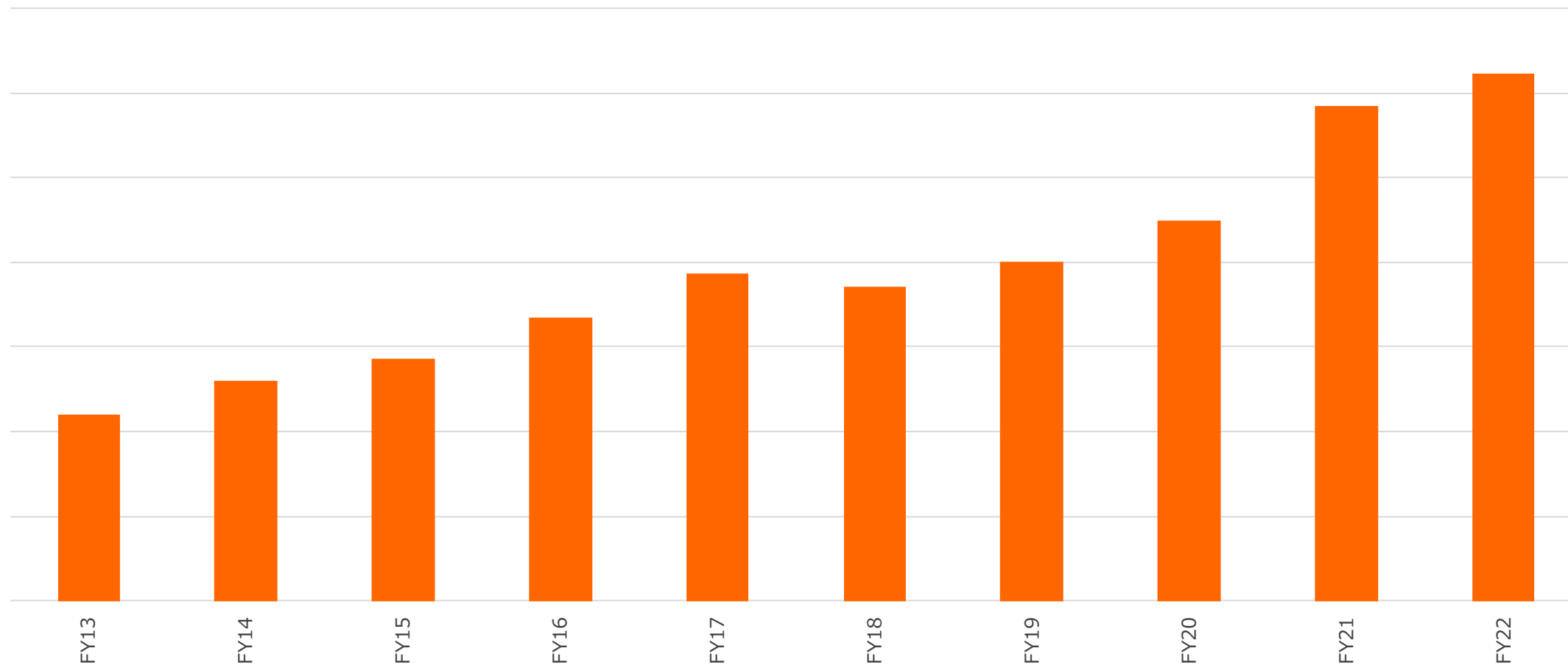
出荷額ベース

通期



出荷額ベース

通期



- 製品群別 用途別 データ集

出荷額ベース

■ 製品群	構成比	QoQ	YoY
	4Q	4Q	4Q
精密加工装置合計	67%	-13%	14%
内、ダイサ	34%	-21%	-17%
ブレードダイサ	19%	-18%	-26%
レーザソー	15%	-24%	-2%
内、グラインダ	30%	-3%	64%
薄化DGP	14%	-20%	35%
薄化以外	16%	20%	102%
内、周辺装置	3%	-18%	-
精密加工ツール	19%	-16%	-13%
その他	15%	19%	-18%
出荷額合計	100%	-10%	2%

従来分類での構成比、増減率

■ 製品群	構成比	QoQ	YoY
	4Q	4Q	4Q
精密加工装置合計	63%	-13%	7%
内、ダイサ	34%	-20%	-17%
ブレードダイサ	19%	-18%	-26%
レーザソー	15%	-24%	-2%
内、グラインダ	30%	-3%	63%
薄化DGP	14%	-20%	35%
薄化以外	16%	20%	102%
内、周辺装置	-	-	-
精密加工ツール	17%	-16%	-18%
その他	19%	6%	9%
出荷額合計	100%	-10%	2%

出荷額ベース

■製品群	構成比	YoY
	2H	2H
精密加工装置合計	68%	25%
内、ダイサ	36%	-4%
ブレードダイサ	20%	-15%
レーザソー	16%	13%
内、グラインダ	28%	69%
薄化DGP	15%	51%
薄化以外	14%	95%
内、周辺装置	4%	-
精密加工ツール	19%	-5%
その他	13%	-26%
出荷額合計	100%	9%

構成比	YoY
	Full Year
65%	27%
37%	5%
22%	-2%
15%	19%
25%	52%
14%	44%
11%	62%
3%	-
21%	7%
14%	-22%
100%	13%

従来分類での構成比、増減率

■製品群	構成比	YoY	構成比	YoY
	2H	2H		
精密加工装置合計	64%	18%	62%	20%
内、ダイサ	36%	-5%	37%	5%
ブレードダイサ	20%	-15%	22%	-2%
レーザソー	16%	13%	15%	19%
内、グラインダ	28%	69%	25%	51%
薄化DGP	15%	51%	14%	44%
薄化以外	14%	95%	11%	62%
内、周辺装置	-	-	-	-
精密加工ツール	18%	-11%	20%	0%
その他	18%	3%	19%	7%
出荷額合計	100%	9%	100%	13%

出荷額ベース

		FY21				FY22			
製品	用途	21-1Q	21-2Q	21-3Q	21-4Q	22-1Q	22-2Q	22-3Q	22-4Q
ダイサ	1_IC	54%	51%	52%	50%	53%	51%	48%	44%
	2_パッケージ・シンギュレーション	15%	16%	16%	13%	14%	10%	8%	8%
	3_光半導体	9%	12%	10%	7%	6%	6%	8%	9%
	4_その他_半導体	10%	11%	18%	19%	22%	24%	29%	32%
	5_非半導体	12%	11%	4%	10%	5%	8%	7%	8%
ダイサ		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
グラインダ	1_IC	56%	51%	41%	49%	51%	47%	55%	39%
	2_光半導体	7%	14%	12%	4%	2%	3%	3%	8%
	3_その他_半導体	19%	12%	28%	25%	32%	35%	29%	33%
	4_素材ウエーハ	11%	16%	13%	14%	14%	13%	11%	15%
	5_非半導体	6%	7%	6%	8%	2%	2%	2%	5%
グラインダ		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

出荷額ベース

		FY21				FY22			
製品		21-1Q	21-2Q	21-3Q	21-4Q	22-1Q	22-2Q	22-3Q	22-4Q
ダイサ	1_IC	63%	71%	80%	13%	16%	16%	2%	-27%
	2_パッケージ・シンギュレーション	89%	84%	118%	37%	11%	-23%	-47%	-53%
	3_光半導体	-51%	1%	115%	12%	-25%	-38%	-20%	8%
	4_その他_半導体	11%	42%	291%	215%	161%	152%	79%	36%
	5_非半導体	15%	32%	-50%	-7%	-50%	-9%	87%	-36%
ダイサ		26%	52%	86%	29%	18%	16%	10%	-17%
グライнда	1_IC	114%	39%	44%	15%	4%	44%	136%	28%
	2_光半導体	-29%	84%	62%	-6%	-71%	-63%	-51%	227%
	3_その他_半導体	-25%	-15%	419%	97%	92%	360%	82%	117%
	4_素材ウエーハ	210%	265%	204%	179%	41%	24%	40%	77%
	5_非半導体	-20%	-13%	-47%	-22%	-62%	-59%	-41%	13%
グライнда		37%	42%	77%	34%	16%	56%	75%	64%

出荷額ベース

		FY21				FY22			
製品		21-1Q	21-2Q	21-3Q	21-4Q	22-1Q	22-2Q	22-3Q	22-4Q
ダイサ	1_IC	-1%	-7%	21%	2%	1%	-7%	6%	-27%
	2_パッケージ・シンギュレーション	27%	1%	18%	-10%	3%	-31%	-17%	-20%
	3_光半導体	27%	26%	5%	-34%	-15%	4%	36%	-10%
	4_その他_半導体	31%	12%	91%	13%	8%	8%	36%	-14%
	5_非半導体	-8%	-15%	-52%	150%	-51%	55%	-2%	-15%
ダイサ		6%	-2%	19%	5%	-4%	-3%	12%	-21%
グラインダ	1_IC	36%	-32%	-2%	27%	23%	-6%	61%	-31%
	2_光半導体	90%	41%	8%	-67%	-41%	78%	42%	119%
	3_その他_半導体	55%	-53%	195%	-8%	51%	12%	17%	10%
	4_素材ウエーハ	141%	6%	1%	8%	22%	-7%	14%	36%
	5_非半導体	-40%	-12%	8%	38%	-71%	-7%	57%	166%
グラインダ		39%	-25%	24%	4%	20%	1%	39%	-3%

検収ベース

■ 構成比	FY2021				FY2022			
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
日本	14%	12%	12%	11%	10%	10%	12%	13%
アメリカ	7%	7%	5%	8%	9%	9%	15%	16%
アジア	73%	76%	76%	76%	73%	73%	66%	62%
シンガポール	8%	12%	10%	12%	11%	10%	10%	9%
台湾	15%	19%	17%	18%	17%	18%	13%	14%
韓国	12%	7%	7%	9%	14%	10%	7%	9%
中国 ※	35%	37%	41%	35%	29%	34%	34%	28%
その他	2%	1%	2%	1%	2%	1%	1%	2%
ヨーロッパ	6%	4%	6%	6%	8%	7%	7%	8%
合計	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

※外資メーカー現地工場向け含む

検収ベース

従来分類	FY21_1Q	2Q	3Q	4Q	FY22_1Q	2Q	3Q	4Q
精密加工装置	50%	58%	56%	60%	53%	61%	58%	66%
精密加工ツール	28%	21%	24%	21%	26%	20%	22%	16%
部品	10%	7%	8%	7%	10%	8%	10%	8%
その他	10%	12%	10%	10%	9%	9%	8%	9%
産業用研削製品	2%	2%	2%	2%	2%	1%	2%	1%

新分類	FY21_1Q	2Q	3Q	4Q	FY22_1Q	2Q	3Q	4Q
精密加工装置	-	-	-	-	56%	65%	61%	71%
精密加工ツール	-	-	-	-	28%	21%	23%	17%
部品	-	-	-	-	10%	8%	10%	8%
その他	-	-	-	-	6%	5%	6%	5%
産業用研削製品	-	-	-	-	-	-	-	-